

MZIT

麟酷[®] LMDG-03 产品规格说明书Lincool[®] LMDG-03 Products Datasheet

中科院理化所及清华大学团队科技成果转化项目

Lincool[®] LMDG-03系列液态金属导热凝胶能很好的满足低应力、高压缩比要求，液态金属的引入使系列凝胶具备高导热、优异高低温耐受性及抵抗热冲击能力，同时兼具传统导热凝胶的良好电绝缘性能。



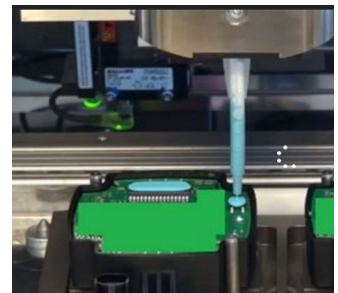
特征与优势

1. 高导热性能；
2. 良好的界面润湿性；
3. 液态金属相变化抵抗瞬时热冲击；
4. 优异的高低温耐受性；
5. 良好的电气绝缘性；
6. 长时间使用稳定可靠。

性能参数		产品型号	测试方法
		LMDG-03	
基础性能	组分数量	A/B双组分	—
	混合比例 (体积比)	1:1	—
	密度 (g/cm^3)	2.8	ASTM D792
	硬度 (Shore 00)	40/70可选	ASTM D2240
	粘度 (P)	>2000	ASTM D2196
	阻燃等级	V-0	UL 94
	金属腐蚀性 (Cu、Al、Fe)	无腐蚀	SH/T0331-92
热学性能	热导率 ($\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$)	5.0	ASTM D5470
	脆化温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-50	ASTM D2137
	使用温度范围 ($^{\circ}\text{C}$)	-45~200	—
电学性能	体积电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	1.7×10^{12}	ASTM D257
	介电强度 (KV/mm)	13.3	ASTMD149-2009
	介电常数@1kHz	5.5	ASTM D150
使用性能	出胶量@90psi, Φ 2mm出胶口 (g/min)	≥ 20	—
	操作时间@40 $^{\circ}\text{C}$ (min)	120	—
	固化时间/温度	12min/120 $^{\circ}\text{C}$	—
	储存时间@25 $^{\circ}\text{C}$	6个月	—

使用方法

1. 除去元器件表面污渍、锈迹、灰尘和油污等异物；
2. 使用点胶机将A、B胶按1:1比例充分混合后按需涂覆到元器件表面；
3. 使用时请注意以下3个事项：（a）严禁与其他任何种类的胶混合使用；
（b）A/B组分混合后，请在操作时间范围内用完；（c）储存在阴凉、干燥环境中。



产品应用

3C产品 通讯基站 显卡芯片 微处理器 汽车电子设备 散热模块

有效管理高功率密度及其产生的极端热量
为军事，激光，车载和航空航天应用设计